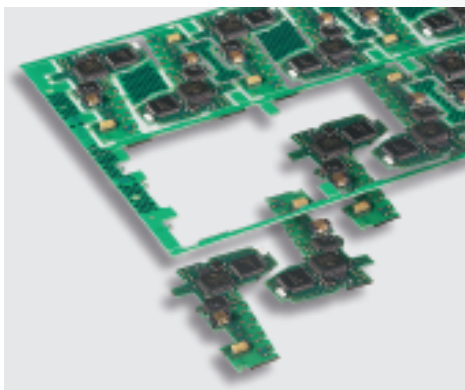
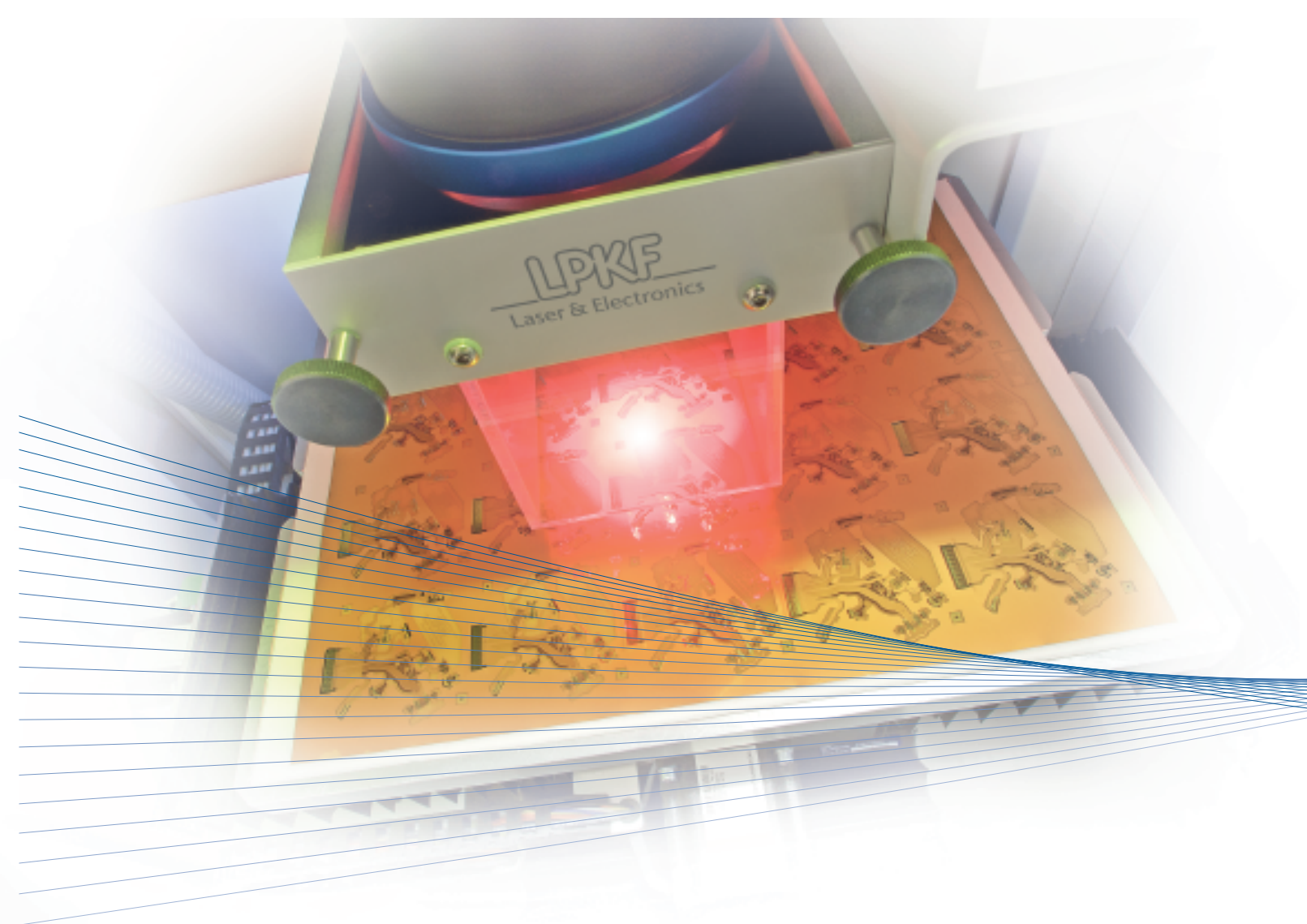


低成本、高质量切割
电路板分板新选择

LPKF MicroLine 1000 S



LPKF
乐普科光电



以光为刀，前景光明...

世界上有很多美好的事情，紫外激光切割电路板就是其中之一，哪怕是最复杂的结构，依然迅速、清洁、精准，令人目眩。LPKF激光电子股份有限公司新近推出的MicroLine 1000 S，正是这样一款紫外激光系统，从事已贴装元器件的电路板分板，经济、高效、引人注目。

低成本的紫外激光加工设备

LPKF MicroLine 1000 S适合断点分割，以及复杂外形切割，切割精度高。与传统加工方式相比，其优势包括，产品上市时间更短，切割质量更高。设备使用的紫外激光，在切割FR4、FR5、CEM、陶瓷、聚酰亚胺、聚酯、以及其它电路板基板材料时，是理想工具，切割边缘清洁、无毛刺。尤其在切割薄而柔软的材料时，与传统切割设备相比激光显示出了强大的优越性。

激光切割基板时产生的汽化物、蒸发物，被设备内置的吸尘口完全吸除，在电路板表面不留任何残留物，实现这些所需的成本与传统切割方式所需的成本相当。

无应力加工，无压力操作

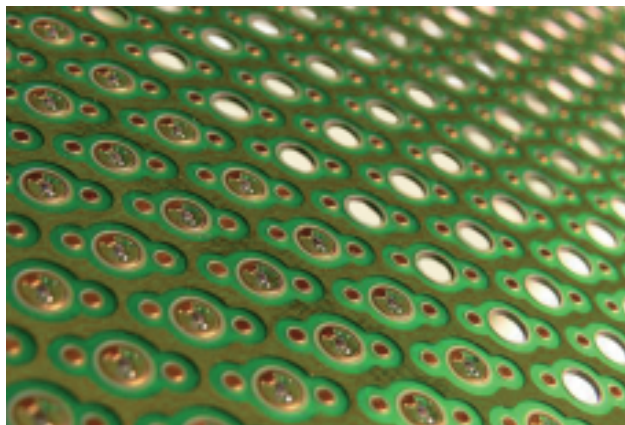
紫外激光可以紧挨敏感元器件和线路切割基板，而不产生任何机械应力，因此元器件可以紧靠电路板边缘放置，从而实现更高装配密度，缩小基板尺寸。这种无应力加工方式还可以在公差要求极其严格的时候，获得较高的CpK，从而大幅提升产品合格率。

极具吸引力的价格和产品质量的提升，对于不断追求创新的制造商来说，是 MicroLine 1000 S的突出优势所在。

MicroLine 1000 S具有价格低、能耗低、重量轻、占地小等特点，更兼具出色的工作效率和优良的切割质量。

LPKF MicroLine 1000 S

- 与机械切割成本相当的激光分板
- 性价比优异
- 多款产品生产，切换容易
- 精度极高，CpK优异



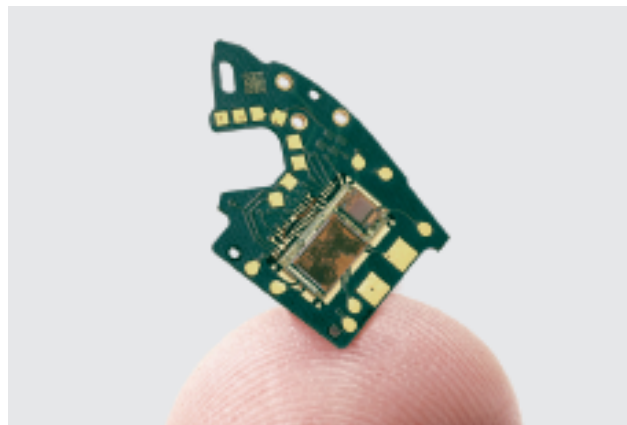
提升加工品质

LPKF MicroLine 1000 S拥有多重优势：

产品转换时间和上市时间不再取决于专用模具和适配治具，只需更换产品切割数据，即可完成产品的转换，提高了生产自由度。

紫外激光切割电路板的尺寸可达305x250mm，光斑直径为20 μ m，非常适合应付沟道极窄，曲度极小的切割需求。对激光输出功率和基板表面的激光功率进行监测，保证切割过程稳定、可靠。

元器件可以紧靠切割线边缘放置，节省了空间和材料。无需预留装夹或者固定电路板的位置。



安全易用

LPKF MicroLine 1000 S 配有特制的激光光源，结构紧凑的具有触摸功能的控制面板，以及简单易用的软件，生产过程，一键操作。设备具有自动聚焦功能，通过自动识别靶标、电路板边缘、或者是独立的断点，即可确定电路板位置，精准切割。

LPKF MicroLine 1000 S结构紧凑，激光安全等级为1级。设备配有一个玻璃安全罩板，可吸收激光反射，防止事故发生。

